



サステナブル高機能材料研究会 2025年度第1回公開研究会

主催：材料・装置・環境技術委員会

◆公開研究会のご案内

研究会テーマ「次世代サブストレイト技術に関する材料、装置、技術動向」

材料環境技術委員会(委員長 坂本 浩捷)サステナブル高機能材料研究会(主査 森貴裕)では、第1回公開研究会を開催致します。

微細化によるムーアの法則が限界を迎える中で、3D、チップレットなどの実装技術並びにそれを支える製造装置、評価装置、実装材料が注目されています。本研究会では「次世代サブストレイト技術に関する材料、装置、技術動向」をテーマに、先端パッケージを支え、世界をリードする実装周辺技術に関して、公開研究会を開催いたします。有識者様のご知見を頂ければと考えております。

開催日時 2025年10月31日(金) 13:30~16:20

開催方式 対面/WEBハイブリッド開催 (Zoom Webinar使用)

開催場所：回路会館地下1F会議室

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

13:30~13:40

オープニング

開会挨拶 材料・環境技術委員会 委員長 坂本 浩捷

13:40~14:10

講演①「次世代基板向け高機能接着剤の開発」

株式会社ADEKA 環境材料開発研究所 太田啓介氏

14:10~14:40

講演②「銀シードセミアディティブ法によるビルドアップフィルム上への微細銅配線形成」

DIC株式会社 新事業統括本部 インキュベーション推進ユニット 村川 昭氏

14:40~15:10

講演③「バンプレス接合を可能にする高耐熱性樹脂の開発」

株式会社ダイセル 研究開発本部 新木直子氏

(休憩10分)

15:20~15:50

講演④ 次世代パッケージ向け ガラス基板PLPソリューション」

東レエンジニアリング株式会社 メカトロファインテック事業本部第一事業部 河村知範氏

15:50~16:20

講演⑤「近赤外光硬化性樹脂を用いた多心一括光接続技術」

宇都宮大学 工学部長 杉原興浩氏

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

定員 回路会館地下1F会議室:50名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)
WEB (Zoom Webinar): 200名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員:5,000円、学生会員:無料、研究会会員:別払い、シニア会員:2,000円
名誉会員:無料、賛助会員の社員:5,000円、賛助会員(クーポン利用):無料
非会員一般:10,000円、非会員学生:2,000円、協賛団体会員:5,000円

注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
 - ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。
(お支払い方法:クレジットカード決済またはコンビニ決済のみ)(手数料学会負担)
 - ③**領収書(宛名会社名選択可)**のご発行は、返信メールのマイページから**決済後に即日出力が可能**です。
 - ④WEBの領収書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
 - ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで(複数口の場合は口数分)利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。※複数枚使用希望がある場合はお問い合わせください。
- * キャンセルポリシー
お申込み後のキャンセルはできません。

下記から参加申し込みをお願いします。

会員

賛助会員

協賛会員

非会員

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会
E-mail: info¥jiep.or.jp (メールアドレスは¥を@に置き換えてください)

協賛団体

(一社)日本電子回路工業会